

第 45 回無機高分子シンポジウム

主題 配位・架橋・ネットワーク：境界を超える無機高分子

趣旨

近年、カーボンニュートラル社会の実現・次世代半導体・電子デバイスの高度化・エネルギー利用の効率化・先端医療の発展などを背景に材料に求められる機能はますます高度化、多様化しています。これに伴い原子・分子レベルで構造を精密に制御し、従来材料では両立が困難であった機能を実現する新しい材料群への期待が集まっております。中でも配位結合や架橋構造より形成される無機高分子は、MOF (Metal-Organic Framework) に代表されるような結晶性多孔体のみならず、非晶質材料・高分子など広い形態を含み、機械特性、界面特性、電子輸送特性などの面で特徴的な機能を有する点から、エネルギー、電子デバイス、接着・構造材料など幅広い分野での応用が期待されています。

無機高分子研究会では、MOF だけでなく、より広義に配位・架橋・ネットワークをとらえ無機高分子の構造設計と機能開拓を着眼し、「配位・架橋・ネットワーク：境界を超える無機高分子」と題したシンポジウムを企画しました。本主題のもと、配位、架橋、ナノ空間を基盤とした無機高分子の最先端研究と応用展開について、産学の第一線の研究者をお招きし、本分野の新たな方向性と可能性についてご紹介いただきます。

主催 高分子学会 無機高分子研究会

協賛 応用物理学会、日本セラミックス協会、日本ゾル-ゲル学会、ケイ素化学協会、日本化学会

日時 2026 年 7 月 17 日 (金) 10:00~17:00

会場 東京理科大学神楽坂キャンパス 森戸記念館第 1 フォーラム

* 対面形式のみにて開催いたします。

プログラム

<10:00~10:10>

開会挨拶

(物質・材料研究機構) 瀬川 浩代 運営委員長

<10:10~11:00>

1. 低次元無機半導体構造を持つ配位高分子の開発

(関西学院大学) 田中 大輔

<11:00~11:50>

2. テトラジックリクケミストリーを活用した亜鉛配位架橋ゴムの特性と架橋ゴム接着への応用

(株式会社ブリヂストン) 小谷 享平

<11:50~13:10> 休憩

<13:10~14:00>

3. 有機ナノ粒子の世界 ～斬新な発想に基づく新規ナノ薬剤の開発まで～

(東北大学) 笠井 均

<14:00~14:50>

4. 11族金属チオラートが形成する配位高分子の機能開拓

(名古屋工業大学) 江口 裕

<14:50~15:20>休憩

<15:20~16:10>

5. 有機ナノケージ分子をプラットフォームとした無機化学

(筑波大学) 二瓶 雅之

<16:10~17:00>

6. 共有結合性有機構造体を活用した燃料電池向けプロトン伝導膜の研究開発

(株式会社デンソー) 佐藤 敬

受付期間 2026年4月6日~ 2026年7月13日

参加要領

1) 定員 100名

2) 参加費(税込) 企業 14,300円、 大学・官公庁 5,500円、 学生 2,200円

名誉会員・終身会員・フェロー・ゴールド会員・シニア会員 2,200円

無機高分子研究会メンバー (a)企業 11,000円 (b)大学・官公庁 4,400円

3) 申込方法 WEBにて申込後、参加費を7月末までにご送金ください。

4) 振込先 銀行振込<三菱UFJ銀行銀座支店(普) 1126232 公益社団法人高分子学会>

※振込手数料は振込人にてご負担くださいますようお願いいたします。

問合先 公益社団法人高分子学会 第45回無機高分子シンポジウム係

〒104-0042 東京都中央区入船3-10-9 新富町ビル6F

電話 03-5540-3770 Fax03-5540-3737

※プログラムは予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さい。